

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2024-007

芯原微电子（上海）股份有限公司

2023年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	233,799.64	267,899.01	-12.73
营业利润	-27,071.86	9,051.74	-399.08
利润总额	-26,922.36	9,368.43	-387.37
归属于母公司所有者的净利润	-29,646.67	7,381.43	-501.64
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-32,543.64	1,329.06	-2548.62
基本每股收益（元）	-0.59	0.15	-493.33
加权平均净资产收益率	-10.54%	2.62%	减少 13.16 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	440,638.10	442,616.01	-0.45
归属于母公司所有者的所有者权益	270,029.36	290,722.04	-7.12
股本	49,991.12	49,775.07	0.43

归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.40	5.84	-7.53
--------------------	------	------	-------

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营状况

2023 年度，公司预计实现营业收入 23.38 亿元，同比下降 12.73%；2023 年预计实现归属于母公司所有者的净利润为-2.96 亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3.25 亿元。

公司报告期内经营状况变化主要影响因素如下：

- ① 2023 年度，全球半导体产业面临严峻挑战，整体市场需求放缓，公司预计实现营业收入 23.38 亿元，同比下降 12.73%。
- ② 2023 年度，公司预计实现毛利 10.46 亿元，同比减少 6.09%。公司 2023 年度综合毛利率预计为 44.75%，较 2022 年度同比提升 3.16 个百分点，主要原因系收入结构变化和一站式芯片定制服务业务毛利率提升所致。
- ③ 公司所处的集成电路行业为高度技术密集型行业，公司坚持高研发投入以保持技术先进性，2023 年度持续深化面向 AIGC、自动驾驶等多个领域的研发布局，推进半导体 IP 和 Chiplet 等技术的研发工作，研发人力成本同比有所增长。2023 年度，公司预计整体研发投入 9.54 亿元，其中研发费用 9.47 亿元，资本化研发投入 0.07 亿元。公司报告期内研发投入占营业收入比重为 40.82%，较去年同期增长 9.58 个百分点。
- ④ 本着谨慎性原则，公司对应收款项余额的客户进行了风险识别，并根据不同风险组合相应计提了信用减值损失准备，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

2、财务状况

报告期末，公司财务状况良好，总资产额为 44.06 亿元，较报告期初基本持平，归属于母公司所有者的所有者权益为 27.00 亿元，较报告期初减少 7.12%。

(二) 主要数据及指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明

公司报告期内营业利润预计同比减少 399.08%，利润总额预计同比减少 387.37%，归属于母公司所有者的净利润预计同比降低 501.64%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计同比降低 2548.62%，基本每股收益预计同比降低 493.33%，上述变动主要由于报告期内公司经营业绩受到整体市场需求放缓等因素所影响，具体内容详见本公告“二/（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素”。

三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日